

Presse-Information



Polymere Technologien

Datum: Juli 2006
Anlage:
Kennziffer: PR-0001-DIS-01072006-TZ101

Neuer Klebstoff mit hoher thermischer Leitfähigkeit

Der einkomponentige Klebstoff Epo-Tek TZ101 wurde zum thermischen Leitkleben von Substraten mit unterschiedlichen linearen Längenausdehnungen entwickelt.

Er besitzt einen sehr niedrigen Ionengehalt und hat eine Topfzeit von 3-4 Wochen.

Epo-Tek TZ101 wird typischerweise als Chipklebstoff, in der Sensorik und in der Festplattenproduktion zum Kontaktieren von Wärmesenken eingesetzt.

Für weitere Informationen fordern Sie das Produktdatenblatt an, oder sprechen Sie mit unseren Produktspezialisten.

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen

Tel. 07243-604-400